

# 차세대 회로기판 Flip Chip “한판”

## 삼성전기 100% 증설에 LG전자 신규참여 ... 일본·타이완 추격전

차세대 회로기판 Flip Chip 시장을 놓고 치열한 경쟁이 전개되고 있다.

반도체 기술의 발달과 함께 연평균 20% 이상 고속 성장하고 있는 차세대 회로기판인 플립칩 시장에서는 일본, 타이완을 따라잡으려는 삼성전자와 LG전자 등 국내 후발기업들의 추격전이 본격화되고 있다.

반도체업계에 따르면, 플립칩 시장은 일본의 이비덴과 신코, 타이완의 Nanya 등이 생산량 기준 60% 이상의 시장점유율을 기록하고 있다.

플립칩은 CPU와 칩셋 등 고성능 반도체를 패키징하는데 사용되는 차세대 회로기판으로, PC와 게임기 시장의 성장세에 맞춰 수요가 급증할 것으로 전망되고 있다.

시장조사기관인 Prismark에 따르면, 2006년 7억9500만개인 플립칩 생산은 2010년 16억4000만개로 증가해 연평균 22%의 가파른 성장세가 지속될 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 후발주자인 삼성전기와 LG전자 등은 플립칩 대량 생산라인을 갖추기 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

우선 플립칩 생산라인 신설을 추진해온 LG전자는 최근 정부가 경기도 오산 인쇄회로기판 공장 설비의 증설을 허용함에 따라 플립칩 시장에 본격적으로 뛰어 들 수 있게 됐다.

LG전자는 2007년부터 오산공장 운동장 부지 3만3000㎡에 플립칩 생산라인을 갖춘 회로기판 공장의 증축공사를 시작할 계획이다.

LG전자 관계자는 “공장 증설이 허용됨에 따라 차세대 단말기용 플립칩 생산을 위한 기반을 조성할 수 있게 됐다”며 “아직 세부계획이 확정되지 않았지만 2007년부터 공사를 시작해 2010년 이후에는 플립칩 양산을 시작할 계획”이라고 밝혔다.

2003년부터 플립칩 시장에 뛰어든 삼성전기도 12월 중순까지 부산공장의 플립칩 2라인 증설공사를 마무리하고 2007년 하반기부터 본격적인 양산에 들어갈 계획이다.

삼성전기 관계자는 “기존의 부산 1라인과 대전 사업장에서 월 1100만개를 생산했지만 부산 2라인이 완공되면 생산량이 월 2400만~2600만개로 2배 가까이 증가하게 된다”며 “일본 등 경쟁기업과 동등한 생산능력을 갖추게 돼 2008년에는 세계 1위 등극도 가능할 것”으로 보고 있다.

일본과 타이완 선발기업들의 방어 노력도 전개되고 있다.

플립칩기판 세계 1위인 일본의 이비덴은 플립칩 시장의 고속 성장에 힘입어 목표치 달성을 2년이나 앞당기는 등 빠르게 덩치를 키우고 있다.

이비덴은 2003년 5개년 계획을 통해 2007년까지 매출 3000억엔, 경상이익 250억엔 달성을 목표로 제시했지만 불과 2년 만인 2005년 매출 3190억엔, 경상이익 450억엔을 기록해 외형과 수익성 모두 목표치를 웃도는 기록을 달성했다.

타이완의 피닉스 프리시전 테크놀로지도 최근 한국법인을 설립하는 등 본격적인 아시아 시장 공략에 박차를 가하고 있고, 타이완 Nanya와 일본 NTK 등도 관련설비 확장을 진행중인 것으로 알려졌다. <저작권자 연합뉴스-무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2006/12/08>